

ウェーハ研削の課題解決を提案します

We propose solutions for grinding wafers



ウェーハ研削用

8インチ・6インチ SiCウェーハ 他

For wafer grinding 8-inch and 6-inch SiC wafers, etc.

NEW!

ビトリファイドダイヤモンドホイール

Vitrified Diamond Wheel nanoVi®

nanoVi®

粗加工 Rough

工具寿命を延ばしたい

Would you like to extend tool lifetime?

高強度ガラス結合剤による
ホイール耐摩耗性の向上

Improved wheel wear resistance
by high strength glass binder

8インチ(レーザー切断面)
SiCウェーハにおいて

摩耗率 12% 達成

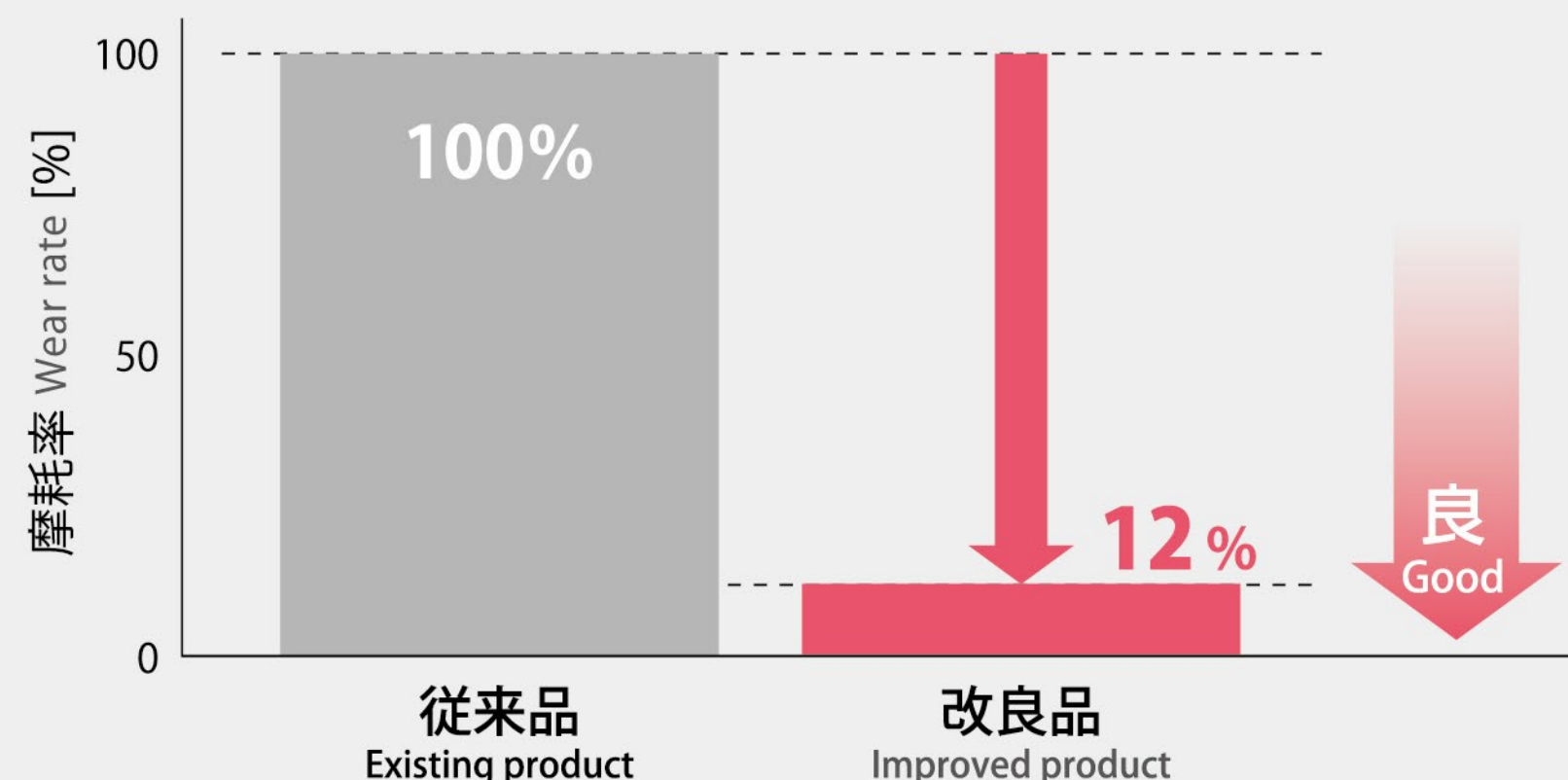
This wheel can achieve 12% wear rate
on 8-inch SiC wafers with laser-sliced surfaces

評価事例
Evaluation example
(SD2000)

送り速度
Feed speed

0.5 $\mu\text{m}/\text{sec}$

摩耗率 Wear rate



仕上げ加工 Finish

加工品質を安定させたい

Would you like to stabilize machining quality?

均一なホイール組織による
砥粒分散性の向上

Improved abrasive grain dispersion
due to uniform wheel structure

8インチ
SiCウェーハにおいて

**連続研削でも
安定した表面品位**

This wheel can provide stable surface quality
even with continuous grinding on 8-inch SiC wafers

評価事例
Evaluation example
(SD30000)

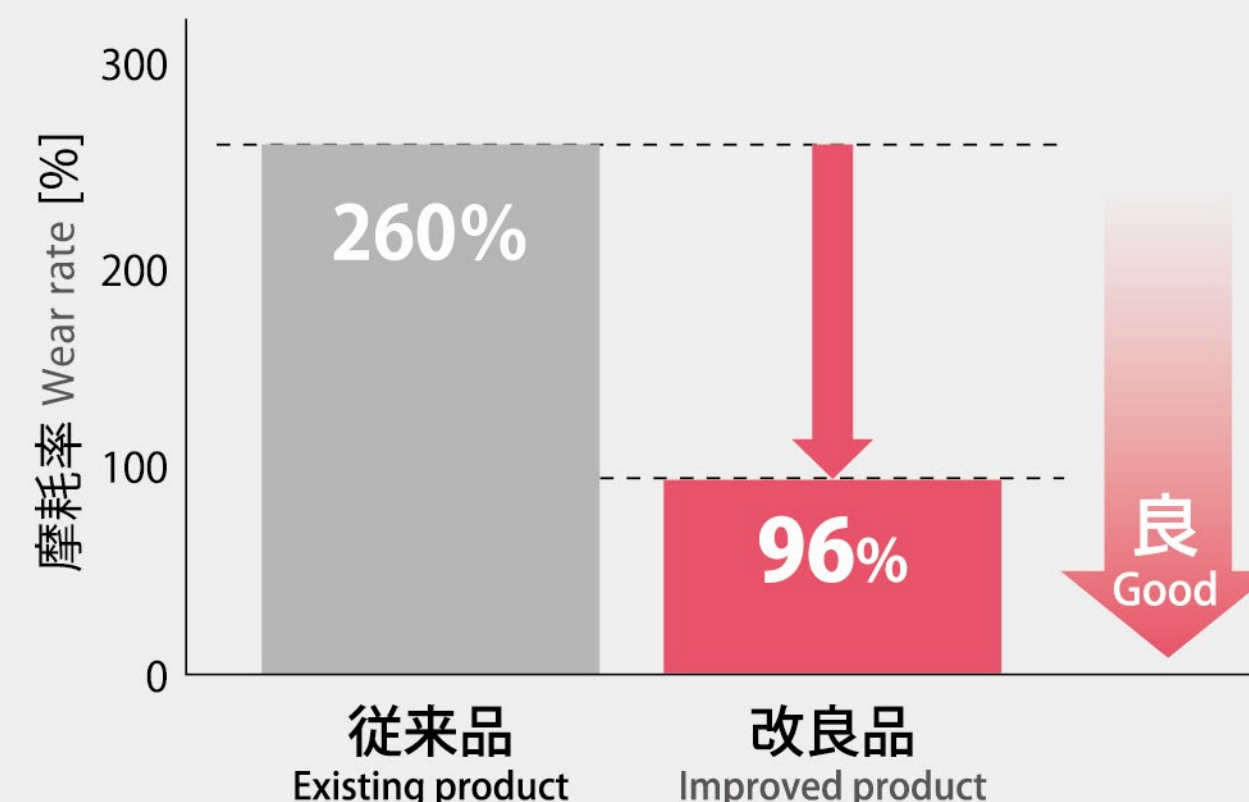
送り速度
Feed speed

0.2 $\mu\text{m}/\text{sec}$

表面あらさ
Surface roughness

**Sa 2nm
以下**
Sa 2nm or less

摩耗率 Wear rate



当社は「つくばパワーエレクトロニクスコンステレーション(TPEC)」に参加し協業で本開発を実施しました

Our company participated in the Tsukuba Power-Electronics Constellations (TPEC) and carried out this development in collaboration with the group.

